

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2024-009

## 深圳市信宇人科技股份有限公司

### 2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度
		调整前	调整后	
营业总收入	658,547,763.48	669,476,458.18	669,476,458.18	-1.63%
营业利润	60,792,571.95	70,788,315.46	70,788,315.46	-14.12%
利润总额	61,311,023.59	70,464,876.99	70,464,876.99	-12.99%
归属于母公司所有者的净利润	61,876,856.56	66,730,415.79	66,728,288.17	-7.27%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	42,487,709.13	50,130,166.07	50,128,038.46	-15.24%
基本每股收益（元）	0.76	0.93	0.93	-18.28%
加权平均净资产收益率	10.85%	20.26%	20.26%	减少 9.41 个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度
		调整前	调整后	
总资产	1,821,264,458.92	1,319,551,724.49	1,320,642,246.45	37.91%
归属于母公司的所有者权益	939,761,435.18	370,328,271.87	370,388,965.28	153.72%
股本	97,754,388.00	73,315,791.00	73,315,791.00	33.33%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	9.61	5.05	5.05	90.30%

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.根据《企业会计准则第 16 号解释》的相关规定，公司对上年同期相关数据进行了追溯调整。

3.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入 658,547,763.48 元，同比下降 1.63%；利润总额 61,311,023.59 元，同比下降 12.99%；归属于母公司所有者的净利润 61,876,856.56 元，同比下降 7.27%；公司总资产 1,821,264,458.92 元，较年初增长 37.91%；归属于母公司的所有者权益 939,761,435.18 元，较年初增长 153.72%。

报告期内，公司业绩变动的主要原因有以下几方面。

1) 公司核心产品 SDC 涂布机销售占比稳步提升，带动毛利率同比有所增长，但毛利额的增长未能覆盖期间费用及信用减值损失的增长。

2) 为保持公司长期竞争力，报告期内公司持续加大研发投入，干法涂布、高速宽幅 SDC 涂布及其核心零部件（模头、风嘴等）、冷液热流干燥技术等研发投入持续增加。同时，为提高新产品的市场渗透率，加大了市场推广力度。从而导致 2023 年研发费用及销售费用同比增长较快。

3) 受行业增速放缓及下游客户资金周转等因素影响，公司应收账款增加导致信用资产减值损失增长。

### （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明：

报告期内，公司完成了 IPO 上市，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额约 5.06 亿元，实现了总资产、归属于母公司股东的所有者权益、股本、归属于母公司股东的每股净资产同比大幅增长，分别为 37.91%、153.72%、33.33%、90.30%。

### （三）2024 年展望

1) 积极加大研发投入，布局如钙钛矿涂布、打孔箔材涂布、干法涂布等新领域涂布的技术攻关，以创新构建技术壁垒。打通上下游产业链，积极推进核心零部件，如：挤压模头及测厚仪的商业化运作；并实现新材料板块从技术平台到创新产品商业化的快速发展，打造公司的第二增长曲线。

2) 公司将积极推进管理变革，提高人均效率，精准费用控制，实现降本增效。

3) 公司会加大应收账款管理力度，完善应收账款回款奖惩机制，积极推进应收账款回款。

### 三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日